

Asunto: Revisión anti plagio

H. Junta Académica del Programa de la Maestría en Derecho

Centro Universitario de la Costa Sur

Presente

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento que el trabajo recepcional titulado

realizado por el (la) alumna (o) _____, con CVU _____ y código _____ de la Maestría en Derecho, fue revisado de manera previa a su presentación y defensa ante el jurado correspondiente, a través de la herramienta anti-plagio denominada Turnitin.

Con base en la revisión realizada por el suscrito director del trabajo recepcional y el análisis del reporte de las similitudes encontradas por dicho software, no se identificaron elementos originales contenidos en alguna obra de terceros que se hagan pasar como propios por el autor del trabajo recepcional¹.

Por ello, se considera que el trabajo recepcional presentado es resultado del esfuerzo individual de su autor y que este empleó las normas y protocolos de citación pertinentes en su desarrollo, por lo cual, se presume que no infringe derechos intelectuales de terceros.

Sin otro particular por el momento, me despido con un cordial saludo.

Atentamente

“PIENSA Y TRABAJA”

2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y capital mundial del libro.

Autlán de Navarro, Jalisco, a ___ de _____ de 202_.

Nombre y firma

Director (a)

Nombre y firma

Vo. Bo.

Coordinador de la Maestría en Derecho

¹ Si bien el plagio como vulneración a los derechos intelectuales no se encuentra previsto en la legislación penal o en materia de propiedad intelectual, para efectos de su comprensión se recurre a la opinión doctrinista argentina Delia Lipszyc, quién señala se refiere al plagio como “el apoderamiento ideal de todos o de algunos elementos originales contenidos en la obra de otro autor presentándolo como propios”. (Ref, Lipszyc Delia, cit. pos. Timal López Sandra y Sánchez Espinoza, Francisco. El plagio en el contexto del derecho de autor. Revista “Tla-melaua” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (online), 2017, vol. 11, n 42, pp 48-66. Disponible en : http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1870-69162017000200048&lng=es&nrm=iso